

Wafer邊緣破損檢測

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw



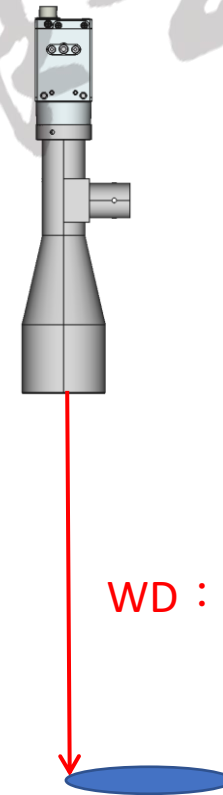
HuiRong

輝榮創研有限公司

測試環境

硬體配置：

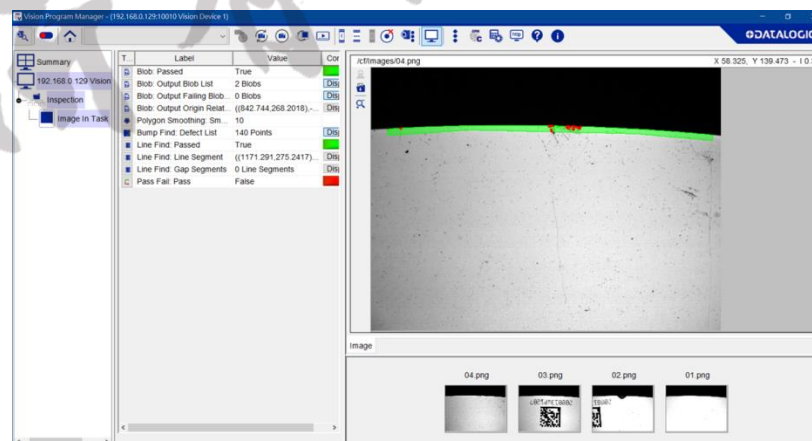
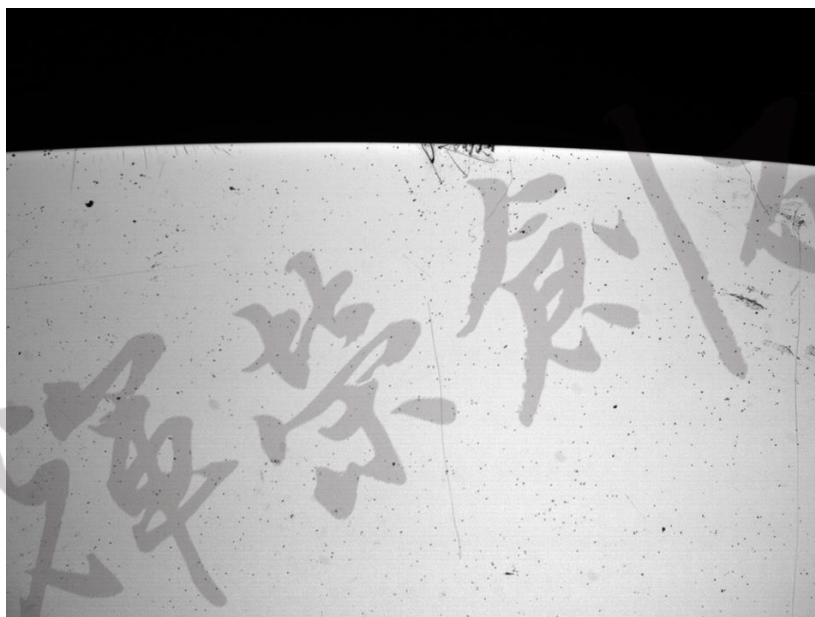
- 相機：
 - 晶片解析：1600 x 1200
 - 像元大小：4.5 μm
 - 晶片大小：7.2 x 5.4 mm (1/1.8")
 - 快門速度：20 μs
 - 取像速度：60 fps
- 鏡頭：HRH03-110CT
 - 倍率：0.3X
 - 工作距離：110 mm
 - 工作視野：24 x 18 mm
 - 視覺精度：15 $\mu\text{m}/\text{pixel}$
- 光源：特殊光場設計，凸顯被測物輪廓邊緣
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw
- 軟體：優化辨識邏輯，使檢測更加準確



HuiRong

輝榮創研有限公司

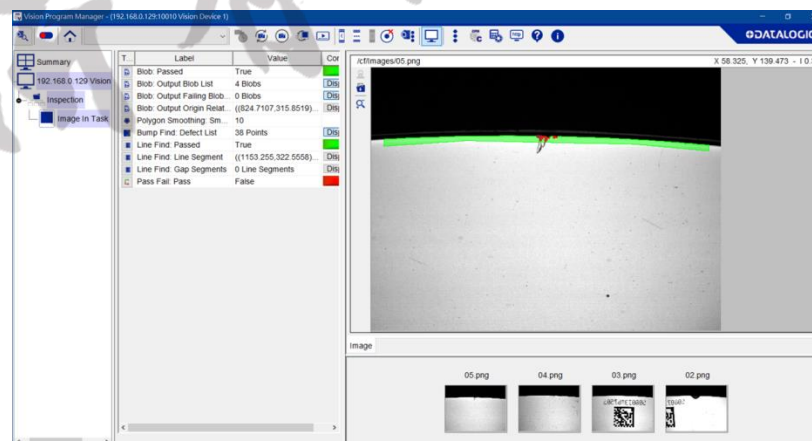
實際檢測結果(破損邊緣)



HuiRong

輝榮創研有限公司

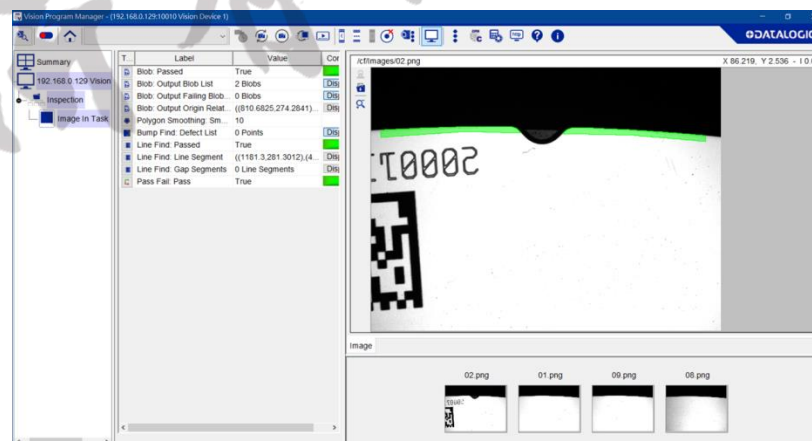
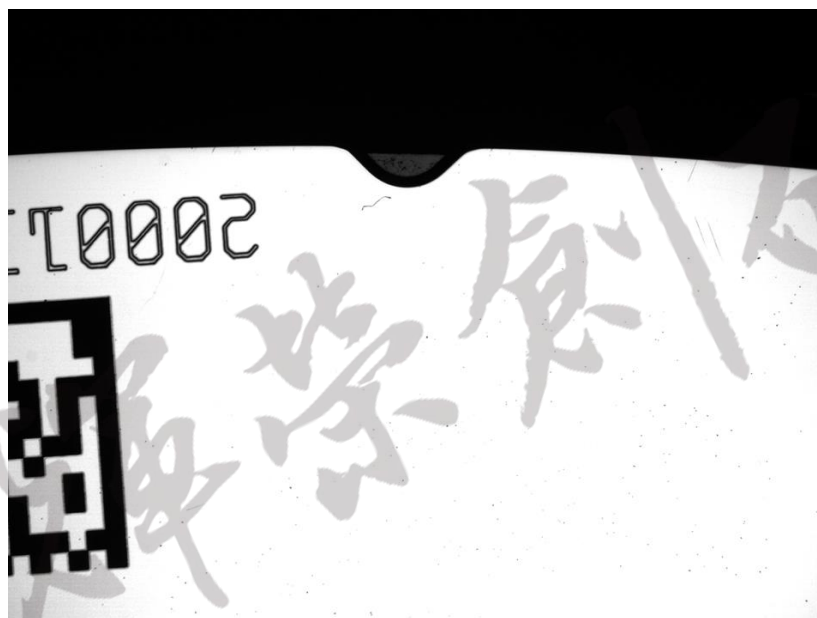
實際檢測結果(破損邊緣)



HuiRong

輝榮創研有限公司

實際檢測結果(Notch)



HuiRong

輝榮創研有限公司